

Docket No.: 60188-581

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Michio MORITA

Serial No.:

Filed: July 29, 2003

For: METHOD FOR FABRICATING MULTILAYER INTERCONNECT AND METHOD FOR
CHECKING THE SAME

:
:
:
:
:
:
:

Group Art Unit:

Examiner:

**CLAIM OF PRIORITY AND
TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT**

Mail Stop CPD
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

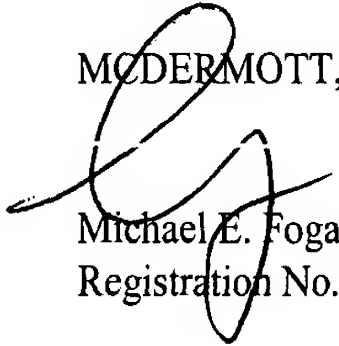
In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicant hereby claims the priority of:

Japanese Patent Application No. 2002-219313, filed July 29, 2002

cited in the Declaration of the present application. A certified copy is submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY


Michael E. Fogarty
Registration No. 36,139

600 13th Street, N.W.
Washington, DC 20005-3096
(202) 756-8000 MEF:mcw
Facsimile: (202) 756-8087
Date: July 29, 2003

60188-581

日本国特許庁 MORITA, M.
JAPAN PATENT OFFICE July 29, 2003.
McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月29日

出願番号

Application Number:

特願2002-219313

[ST.10/C]:

[JP2002-219313]

出願人

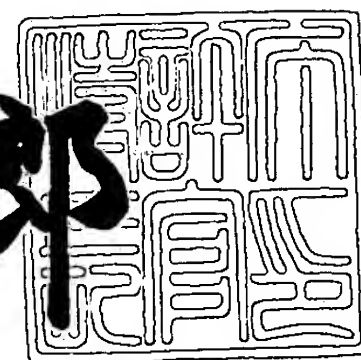
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年 4月18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3028272

【書類名】 特許願

【整理番号】 2926430394

【提出日】 平成14年 7月29日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H01L 21/768

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式
会社内

【氏名】 森田 倫生

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077931

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 弘

【選任した代理人】

【識別番号】 100094134

【弁理士】

【氏名又は名称】 小山 廣毅

【選任した代理人】

【識別番号】 100110939

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 宏

【選任した代理人】

【識別番号】 100110940

【弁理士】

【氏名又は名称】 嶋田 高久

【選任した代理人】

【識別番号】 100113262

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹内 祐二

【選任した代理人】

【識別番号】 100115059

【弁理士】

【氏名又は名称】 今江 克実

【選任した代理人】

【識別番号】 100115510

【弁理士】

【氏名又は名称】 手島 勝

【選任した代理人】

【識別番号】 100115691

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤田 篤史

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014409

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0006010

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多層配線の形成方法及びその検査方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 の絶縁膜の上部に下層配線を形成した後、該下層配線の上を含む前記第 1 の絶縁膜上に第 2 の絶縁膜と第 3 の絶縁膜とを順次形成する第 1 の工程と、

前記第 3 の絶縁膜における前記下層配線の上側に孔部を形成する第 2 の工程と、

前記第 3 の絶縁膜の上部に前記孔部の上部を含むように配線溝を形成すると共に、前記第 2 の絶縁膜における前記孔部の下側部分の膜厚を前記下層配線が露出しないように小さくする第 3 の工程と、

前記第 2 の絶縁膜における前記孔部の下側部分を除去して前記下層配線を露出する第 4 の工程と、

前記孔部及び配線溝に導電膜を埋め込むことにより、上層配線及び該上層配線と前記下層配線とを電氣的に接続する接続部をそれぞれ形成する第 5 の工程とを備えていることを特徴とする多層配線の形成方法。

【請求項 2】 前記第 2 の工程は、前記第 2 の絶縁膜における前記孔部の下側部分の膜厚を小さくする工程を含んでいることを特徴とする請求項 1 に記載の多層配線の形成方法。

【請求項 3】 前記第 2 の絶縁膜及び前記第 3 の絶縁膜はそれぞれ窒化シリコン及び酸化シリコンからなり、

前記第 2 の工程において、前記孔部はフルオロカーボンガスと酸素ガスとを含む第 1 のエッチングガスを用いたドライエッチング法によって形成し、

前記第 3 の工程において、前記配線溝はフルオロカーボンガスと酸素ガスとを含む第 2 のエッチングガスを用いたドライエッチング法によって形成することを特徴とする請求項 2 に記載の多層配線の形成方法。

【請求項 4】 前記第 2 の工程は、前記第 1 のエッチングガスにおける酸素ガスに対するフルオロカーボンガスの比及びフルオロカーボンガスにおけるフッ素に対する炭素の比の値をそれぞれ調整することにより、前記第 2 の絶縁膜にお

ける前記孔部の下側部分のエッチング深さを調節することを特徴とする請求項 3 に記載の多層配線の形成方法。

【請求項 5】 前記第 3 の工程は、前記第 2 のエッチングガスにおける酸素ガスに対するフルオロカーボンガスの比及びフルオロカーボンガスにおけるフッ素に対する炭素の比の値をそれぞれ調整することにより、前記第 2 の絶縁膜における前記孔部の下側部分のエッチング深さを調節することを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の多層配線の形成方法。

【請求項 6】 前記第 1 の工程と前記第 2 の工程との間に、前記第 2 の絶縁層の上の全面にわたって反射防止膜を形成する工程をさらに備え、

前記第 2 の工程は、前記反射防止膜における前記孔部が形成される領域を除去する工程を含み、

前記第 3 の工程は、前記反射防止膜における前記配線溝が形成される領域を除去する工程を含むことを特徴とする請求項 1 ～ 6 のうちのいずれか 1 項に記載の多層配線の形成方法。

【請求項 7】 前記反射防止膜は、膜厚が前記第 2 の絶縁膜の膜厚よりも小さい酸化窒化シリコンからなり、

前記第 3 の工程において、前記反射防止膜は、エッチング装置における下部電極温度が 3 0 ℃ 以上の条件でエッチングすることにより除去することを特徴とする請求項 6 に記載の多層配線の形成方法。

【請求項 8】 前記第 4 の工程において、前記下層配線は、エッチング装置のバイアス電力が 5 0 0 W 以下の条件でエッチングすることにより露出することを特徴とする請求項 1 ～ 7 のうちのいずれか 1 項に記載の多層配線の形成方法。

【請求項 9】 第 1 の絶縁膜の上部に下層配線を形成した後、該下層配線の上を含む前記第 1 の絶縁膜上に全面にわたって第 2 の絶縁膜と第 3 の絶縁膜とを順次形成する第 1 の工程と、前記第 3 の絶縁膜における前記下層配線の上側に孔部を形成する第 2 の工程と、前記第 3 の絶縁膜の上部に前記孔部の上部を含むように配線溝を形成すると共に、前記孔部の下側部分の膜厚を前記下層配線が露出しないように小さくする第 3 の工程と、前記第 2 の絶縁膜における前記孔部の下側部分を除去して前記下層配線を露出する第 4 の工程と、前記孔部及び配線溝に

導電膜を埋め込むことにより、上層配線及び該上層配線と前記下層配線とを電氣的に接続する接続部を形成する第5の工程とを備えた多層配線の形成方法により形成される多層配線の検査方法であって、

前記第1の絶縁膜の上部に検査用下層配線を形成した後、該検査用下層配線の上を含む前記第1の絶縁膜上に全面にわたって前記第2の絶縁膜と前記第3の絶縁膜とを順次形成する工程と、

前記第2の工程と同一の形成方法により、前記第3の絶縁膜における前記検査用下層配線の上側に検査用孔部を形成する工程と、

前記第3の工程と同一の形成方法により、前記第3の絶縁膜の上部に前記孔部の上部を含むように検査用配線溝を形成する工程と、

前記検査用孔部及び検査用配線溝に前記導電膜を埋め込むことにより、それぞれ検査用電極及び検査用上層配線を形成する工程と、

前記検査用下層配線及び検査用上層配線に所定の電圧を印加することにより、前記検査用下層配線と前記検査用上層配線との間が導通するか否かを検査する工程と、

前記検査用下層配線と前記検査用上層配線との間が導通しない場合には前記第3の工程により前記下層配線が露出しないと判定し、且つ前記検査用下層配線と前記検査用上層配線との間が導通する場合には前記第3の工程により前記下層配線が露出すると判定する工程とを備えていることを特徴とする多層配線の検査方法。

【請求項10】 前記検査用電極は、前記検査用下層配線と前記検査用上層配線との間に並列に配置されていることを特徴とする請求項9に記載の多層配線の検査方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、下層配線と上層配線とがビアコンタクトにより接続された多層配線の形成方法及びその検査方法に関し、特に層間絶縁膜に形成したビアホール及び配線溝に同一の導電性材料を埋め込むことによりビアコンタクトと上層配線とを

形成するデュアルダマシン法を用いた多層配線の形成方法及びその検査方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来、半導体集積回路装置等に用いる高密度の配線として、下層配線と上層配線とがビアコンタクトにより接続された多層配線が用いられている。このような多層配線を形成する技術には、下層配線の上にビアコンタクトと上層配線と同時に埋め込み形成することにより多層配線を形成するデュアルダマシン法が知られている。

【 0 0 0 3 】

以下、従来のデュアルダマシン法を用いた多層配線の形成方法について図面を参照しながら説明する。

【 0 0 0 4 】

図 5 (a) ～ 図 5 (c) 、 図 6 (a) 、 図 6 (b) 、 図 7 (a) 及び 図 7 (b) は、従来の多層配線の形成方法における工程順の断面構成を示している。

【 0 0 0 5 】

まず、図 5 (a) に示すように、集積回路素子が形成された半導体基板 1 0 1 の上に、第 1 の層間絶縁膜 1 0 2 を形成し、フォトリソグラフィ法及びドライエッチング法を用いて下層配線形成領域を開口し、スパッタ法又は金属めっき法を用いて下層配線形成領域に銅を堆積した後、化学機械的研磨 (C M P : Chemical Mechanical Polishing) 法を用いて第 1 の層間絶縁膜 1 0 2 が露出するまで研磨することにより、第 1 の層間絶縁膜 1 0 2 の上部に銅からなる下層配線 1 0 3 を形成する。

【 0 0 0 6 】

次に、図 5 (b) に示すように、プラズマ化学気相堆積 (プラズマ C V D) 法により、窒化シリコンからなるエッチング停止層 1 0 4 及び酸化シリコンからなる第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 を順次堆積する。

【 0 0 0 7 】

続いて、スピンコート法により、第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 の上に有機材料から

なる第1の反射防止膜106を形成する。

【0008】

次に、図5(c)に示すように、フォトリソグラフィ法を用いて第1のレジストパターン107を形成した後、形成した第1のレジストパターン107をマスクとしたドライエッチング法により、第1の反射防止膜106及び第2の層間絶縁膜105を順次エッチングすることにより、第2の層間絶縁膜105に孔部105aを形成する。

【0009】

次に、図6(a)に示すように、アッシングにより第1のレジストパターン107及び第1の反射防止膜106を順次除去し、続いて第2の層間絶縁膜105の表面を洗浄した後、スピコート法により有機材料からなる第2の反射防止膜108を孔部105aの内部を充填するように形成する。

【0010】

次に、図6(b)に示すように、フォトリソグラフィ法を用いて第2のレジストパターン109を形成した後、形成した第2のレジストパターン109をマスクとしたドライエッチング法により、第2の反射防止膜108及び第2の層間絶縁膜105を順次パターンニングして配線溝105bを形成する。

【0011】

ここで、孔部105aに充填された第2の反射防止膜108のエッチング速度が第2の層間絶縁膜105のエッチング速度と比べて遅いことにより、孔部105aに充填された第2の反射防止膜108が孔部105aの下側に位置する下層配線103及びエッチング停止層104を配線溝105b形成時のダメージから保護する。

【0012】

なお、配線溝105bを形成する際に、第2の層間絶縁膜105における第2の反射防止膜108と接する領域がエッチング除去されず、配線溝105bにおける孔部105aの周囲に突起状のエッチング残渣としてクラウンフェンス105cが生じることがある。

【0013】

次に、図 7 (a) に示すように、アッシングにより第 2 の反射防止膜 1 0 8 及び第 2 のレジストパターン 1 0 9 を除去し、続いて第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 の表面を洗浄した後、第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 をマスクとしたドライエッチング法により、孔部 1 0 5 a の下に露出したエッチング停止層 1 0 4 を除去して下層配線 1 0 3 を露出する。これにより、エッチング停止層 1 0 4 及び第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 を貫通して下層配線 1 0 3 まで達するビアホールが形成される。

【 0 0 1 4 】

次に、図 7 (b) に示すように、スパッタ法又は金属めっき法を用いて、第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 の上に孔部 1 0 5 a 及び配線溝 1 0 5 b を充填するように銅からなる金属膜 1 1 0 を堆積する。その後、CMP 法により、第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 が露出するまで銅を研磨することにより、孔部 1 0 5 a に位置する金属膜 1 1 0 をビアコンタクト 1 1 0 a とし、配線溝 1 0 5 b に位置する金属膜 1 1 0 を上層配線 1 1 0 b とする多層配線が形成される。

【 0 0 1 5 】

また、第 1 の従来例の図 6 (b) に示すクラウンフェンス 1 0 5 c の発生を防止する試みとして、孔部 1 0 5 a の下部に有機膜を形成した後に配線溝を形成する半導体装置の製造方法が知られている。

【 0 0 1 6 】

以下、第 2 の従来例として、孔部 1 0 5 a の下部に有機膜を形成した後に配線溝を形成する多層配線の形成方法について図面を参照しながら説明する。

【 0 0 1 7 】

図 8 (a) 及び図 8 (b) は、第 2 の従来例の多層配線の形成方法における工程順の断面構成を示している。なお、図 8 において、第 1 の従来例と同一の部材については同一の符号を付すことにより説明を省略する。

【 0 0 1 8 】

第 2 の従来例では、まず、第 1 の従来例の図 5 (a) ～図 5 (c) に示す工程と同様にして第 2 の層間絶縁膜 1 0 5 に孔部 1 0 5 a を形成する。

【 0 0 1 9 】

次に、図 8 (a) に示すように、第 1 のレジストパターン 1 0 7 を除去し、続

いて第2の層間絶縁膜105の表面を洗浄した後、スピコート法により孔部105aの内部を充填するように第1の反射防止膜106上の全面にわたって有機材料を塗布し、全面エッチングを行って孔部105aの底部に有機材料からなる有機膜111を形成する。ここで、有機膜111は次の配線溝105bを形成する工程におけるエッチングのダメージから下層配線103を保護する。

【0020】

次に、図8(b)に示すように第2のレジストパターン109をマスクとしたドライエッチング法により配線溝105bを形成する。

【0021】

その後、図7(a)及び図7(b)に示す工程と同様にして孔部105a及び配線溝105bに銅を堆積することにより多層配線を形成する。

【0022】

第2の従来例では、配線溝105b形成領域となる孔部105aの上部に有機膜が充填されないため、クラウンフェンスを生じることなく配線溝105bを形成できる。

【0023】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記第1の従来例に係る多層配線の形成方法によると、配線溝105bを形成する工程において、下層配線103をエッチングのダメージから保護するために孔部105aに有機材料を充填するため、配線溝105bにおける孔部105aと接する領域にクラウンフェンス105cが生じるので、上層配線110bとビアコンタクト110aとの間の抵抗が増加する。さらに、クラウンフェンス105cの大きさによっては上層配線110bとビアコンタクト110aとが電氣的に分離された状態となる。このように、第1の従来例の多層配線の形成方法によると、多層配線の信頼性が低下すると共に製造歩留まりが低下するという問題を有している。

【0024】

これに対し、第2の従来例に係る多層配線の形成方法を用いてクラウンフェンスが生じないように配線溝110bを形成する場合には、製造工程が増加するた

め製造コストが増大するという問題が生じる。

【 0 0 2 5 】

また、第 1 及び第 2 の従来例では、孔部 1 0 5 a の下側に位置するエッチング停止層 1 0 4 を除去してビアホールを形成する工程において、表面に露出した下層配線 1 0 3 がエッチング時のプラズマガスにより腐食され、多層配線の信頼性が低下するという問題をも有している。

【 0 0 2 6 】

本発明は、前記従来の問題を解決し、クラウンフェンスが生じないように配線溝を形成し、且つビアホール及び配線溝を形成する工程のエッチングによるダメージから下層配線を保護して多層配線の信頼性及び製造歩留まりを向上できるようにすることを目的とする。

【 0 0 2 7 】

【課題を解決するための手段】

前記の目的を達成するため、本発明は、層間絶縁膜に孔部と配線溝とを形成する工程において、下層配線の上部のエッチング停止層を、下層配線が露出しないようにエッチングする構成とする。

【 0 0 2 8 】

具体的に、本発明の多層配線の形成方法は、第 1 の絶縁膜の上部に下層配線を形成した後、該下層配線の上を含む第 1 の絶縁膜上に第 2 の絶縁膜と第 3 の絶縁膜とを順次形成する第 1 の工程と、第 3 の絶縁膜における下層配線の上側に孔部を形成する第 2 の工程と、第 3 の絶縁膜の上部に孔部の上部を含むように配線溝を形成すると共に、第 2 の絶縁膜における孔部の下側部分の膜厚を下層配線が露出しないように小さくする第 3 の工程と、第 2 の絶縁膜における孔部の下側部分を除去して下層配線を露出する第 4 の工程と、孔部及び配線溝に導電膜を埋め込むことにより、上層配線及び該上層配線と下層配線とを電氣的に接続する接続部を形成する第 5 の工程とを備えている。

本発明の多層配線の形成方法によると、孔部の上部を含む第 3 の絶縁膜の上部に配線溝を形成すると共に、孔部の下側に位置する第 2 の絶縁膜の膜厚を下層配

線が露出しないように小さくする工程を備えているため、孔部及び配線溝を形成する工程では、第2の絶縁膜により下層配線を保護することができ、下層配線を保護するための有機膜を第3の絶縁膜の孔部に充填しないので、配線溝にクラウンフェンスが生じることがない。また、第2の絶縁膜における孔部の下側部分を除去して下層配線を露出する工程において、エッチング装置の電力を小さくしてエッチング停止層を除去することにより、下層配線がエッチングによって受けるダメージが低減される。従って、製造コストを増大させることなく、多層配線の信頼性及び製造歩留まりを向上することができる。

【 0 0 2 9 】

本発明の多層配線の形成方法において、第2の工程は、第2の絶縁膜における孔部の下側部分の膜厚を小さくする工程を含んでいることが好ましい。

【 0 0 3 0 】

本発明の多層配線の形成方法において、第2の絶縁膜及び第3の絶縁膜はそれぞれ窒化シリコン及び酸化シリコンからなり、第2の工程において、孔部はフルオロカーボンガスと酸素ガスとを含む第1のエッチングガスを用いたドライエッチング法によって形成し、第3の工程において、配線溝はフルオロカーボンガスと酸素ガスとを含む第2のエッチングガスを用いたドライエッチング法によって形成することが好ましい。このようにすると、エッチングガスの組成を調整して窒化シリコンと酸化シリコンとのエッチング選択比の値を適宜設定することにより、下層配線を露出しないように第2の絶縁膜の膜厚を小さくすることができる。

【 0 0 3 1 】

本発明の多層配線の形成方法において、第2の工程は、第1のエッチングガスにおける酸素ガスに対するフルオロカーボンガスの比及びフルオロカーボンガスにおけるフッ素に対する炭素の比の値をそれぞれ調整することにより、第2の絶縁膜における孔部の下側部分のエッチング深さを調節することが好ましい。このようにすると、孔部を形成する工程において第3の絶縁膜をオーバーエッチングするようにエッチング時間を設定する際に、エッチングガスの窒化シリコンに対する酸化シリコンのエッチング選択比の値により第2の絶縁膜がエッチングされ

る深さを設定することができる。

【 0 0 3 2 】

本発明の多層配線の形成方法において、第3の工程は、第2のエッチングガスにおける酸素ガスに対するフルオロカーボンガスの比及びフルオロカーボンガスにおけるフッ素に対する炭素の比の値をそれぞれ調整することにより、第2の絶縁膜における孔部の下側部分のエッチング深さを調節することが好ましい。このようにすると、配線溝を形成する工程において、第3の絶縁膜をオーバーエッチングするようにエッチング時間を設定する際に、エッチングガスの窒化シリコンに対する酸化シリコンのエッチング選択比の値と配線溝の深さとに応じて第2の絶縁膜がエッチングされる深さを設定することができる。これにより、第3の工程によって下層配線が露出しないように配線溝を形成することができる。

【 0 0 3 3 】

本発明の多層配線の形成方法は、第1の工程と第2の工程との間に、第2の絶縁層の上の全面にわたって反射防止膜を形成する工程をさらに備え、第2の工程は、反射防止膜における孔部が形成される領域を除去する工程を含み、第3の工程は、反射防止膜における配線溝が形成される領域を除去する工程を含むことが好ましい。このようにすると、孔部及び配線溝のパターニングの精度が向上する。

【 0 0 3 4 】

本発明の多層配線の形成方法において、反射防止膜は、膜厚が第2の絶縁膜の膜厚よりも小さい酸化窒化シリコンからなり、第3の工程において、反射防止膜は、エッチング装置における下部電極温度が30℃以上の条件でエッチングすることにより除去することが好ましい。このようにすると、窒化シリコンに対する酸化窒化シリコンのエッチング選択比の値が1よりも大きくなるため、窒化シリコンを用いて第2の絶縁膜を形成した場合に下層配線が露出することがない。

【 0 0 3 5 】

本発明の多層配線の形成方法の第4の工程において、下層配線は、エッチング装置のバイアス電力が500W以下の条件でエッチングすることにより露出することが好ましい。このようにすると、第2の絶縁膜を確実に除去することができ

、さらに孔部の下側に露出した下層配線に与えるダメージを低減することができる。

【 0 0 3 6 】

本発明の多層配線の検査方法は、第 1 の絶縁膜の上部に下層配線を形成した後、該下層配線の上を含む第 1 の絶縁膜上に全面にわたって第 2 の絶縁膜と第 3 の絶縁膜とを順次形成する第 1 の工程と、第 3 の絶縁膜における下層配線の上側に孔部を形成する第 2 の工程と、第 3 の絶縁膜の上部に孔部の上部を含むように配線溝を形成すると共に、孔部の下側部分の膜厚を下層配線が露出しないように小さくする第 3 の工程と、第 2 の絶縁膜における孔部の下側部分を除去して下層配線を露出する第 4 の工程と、孔部及び配線溝に導電膜を埋め込むことにより、上層配線及び該上層配線と下層配線とを電氣的に接続する接続部を形成する第 5 の工程とを備えた多層配線の形成方法により形成される多層配線の検査方法を対象とし、第 1 の絶縁膜の上部に検査用下層配線を形成した後、該検査用下層配線の上を含む第 1 の絶縁膜上に全面にわたって第 2 の絶縁膜と第 3 の絶縁膜とを順次形成する工程と、第 2 の工程と同一の形成方法により、第 3 の絶縁膜における検査用下層配線の上側に検査用孔部を形成する工程と、第 3 の工程と同一の形成方法により、第 3 の絶縁膜の上部に孔部の上部を含むように検査用配線溝を形成する工程と、検査用孔部及び検査用配線溝に導電膜を埋め込むことにより、それぞれ検査用電極及び検査用上層配線を形成する工程と、検査用下層配線及び検査用上層配線に所定の電圧を印加することにより、検査用下層配線と検査用上層配線との間が導通するか否かを検査する工程と、検査用下層配線と検査用上層配線との間が導通しない場合には第 3 の工程により下層配線が露出しないと判定し、且つ検査用下層配線と検査用上層配線との間が導通する場合には第 3 の工程により下層配線が露出すると判定する工程とを備えている。

【 0 0 3 7 】

本発明の多層配線の検査方法によると、検査用下層配線と検査用上層配線との間が導通しない場合には第 3 の工程により下層配線が露出しないと判定し、検査用下層配線と検査用上層配線との間が導通する場合には第 3 の工程により下層配線が露出すると判定する工程を備えているため、下層配線が露出すると判定され

た場合にはエッチング条件を再設定することにより、第3の工程において下層配線が確実に露出しないように配線溝を形成することができ、多層配線の信頼性を確保することができる。

【0038】

本発明の多層配線の検査方法において、検査用電極は、検査用下層配線と検査用上層配線との間に並列に配置されていることが好ましい。このようにすると、並列に配列された複数の検査用電極のうちの1つが下層配線と接続されている場合には検査用下層配線と検査用上層配線とが導通するため、多層配線の形成工程に生じる異常を容易に且つ感度良くで検出できる。

【0039】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態に係る多層配線の形成方法について図面を参照しながら説明する。図1(a)～図1(c)及び図2(a)～図2(c)は本実施形態の多層配線の形成方法における工程順の断面構成を示している。

【0040】

まず、図1に示すように、例えば、素子電極を有する半導体集積回路（図示せず）が形成された半導体基板11上の全面に酸化シリコンからなる第1の層間絶縁膜12を形成し、フォトリソグラフィ法及びドライエッチング法を用いて、素子電極の上側を開口するように下層配線形成領域をパターニングし、パターニングした下層配線形成領域にスパッタ法又は金属めっき法を用いて例えば銅を埋め込んだ後、化学機械研磨（CMP：Chemical Mechanical Polishing）法を用いて第1の層間絶縁膜12が露出するまで研磨することにより、第1の層間絶縁膜12の上部に素子電極と接続される下層配線13を形成する。

【0041】

次に、図1(b)に示すように、プラズマ化学気相堆積（プラズマCVD）法により、膜厚が約150nmの窒化シリコンからなるエッチング停止層14、膜厚が約700nmの酸化シリコンからなる第2の層間絶縁膜15及び膜厚が約80nmの酸化窒化シリコンからなる反射防止膜16を順次堆積する。

【0042】

次に、図 1 (c) に示すように、フォトリソグラフィ法を用いて配線部の上部に開口部を有する第 1 のレジストパターン 1 7 を形成した後、エッチングガスにフルオロカーボンガスと酸素ガスとの混合ガスを用いたドライエッチング法により、第 1 のレジストパターン 1 7 をマスクとして反射防止膜 1 6 及び第 2 の層間絶縁膜 1 5 を順次エッチングして第 2 の層間絶縁膜 1 5 に孔部 1 5 a を設ける。

【 0 0 4 3 】

孔部 1 5 a を形成する工程において、第 1 のレジストパターン 1 7 の形成時の面積に対する開口部の面積の比率（マスク開口率）が約 1 パーセントと極めて小さいため、プラズマ発光の強度変化によりエッチング終点を検出することが困難である。このような低開口率のエッチングではエッチング時間の調整によりエッチングの深さを調節する。ここでは、第 2 の層間絶縁膜 1 5 が確実に除去されるように、エッチング停止層 1 4 の上部をもエッチングする設定としており、エッチング停止層 1 4 に凹部 1 4 a が形成される。

【 0 0 4 4 】

ここで、孔部 1 5 a を形成する工程において、凹部 1 4 a の深さが 3 0 n m よりも小さくなるように、エッチング条件を設定する。具体的には、第 2 の層間絶縁膜 1 5 が確実に除去されるように、第 2 の層間絶縁膜 1 5 及び反射防止膜 1 6 の膜厚のばらつきとエッチング速度のばらつきとを考慮して、第 2 の層間絶縁膜 1 5 が約 3 0 0 n m の深さ分だけオーバーエッチングされるようにエッチング時間を設定し、また、窒化シリコンに対する酸化シリコンのエッチング選択比の値が 1 0 よりも大きくなるようにエッチングガスの組成を設定する。これにより、エッチング停止層 1 4 がエッチングされる深さは 3 0 n m よりも小さくなる。

【 0 0 4 5 】

次に、図 2 (a) に示すように、アッシングにより第 1 のレジストパターン 1 7 を除去し、続いて第 2 の層間絶縁膜 1 5 の表面を洗浄した後、フォトリソグラフィ法により、反射防止膜 1 6 の上に第 2 のレジストパターン 1 8 を形成する。その後、エッチングガスにフルオロカーボンガスと酸素ガスとの混合ガスを用いたドライエッチング法により、第 2 のレジストパターン 1 8 をマスクとして反射防止膜 1 6 及び第 2 の層間絶縁膜 1 5 を順次パターニングして、反射防止膜 1 6

の上面からの深さが約 4 0 0 n m の配線溝 1 5 b を設ける。

【 0 0 4 6 】

ここで、配線溝 1 5 b を形成する工程において、孔部 1 5 a の下部に露出するエッチング停止層 1 4 もまたエッチングされるため、エッチング停止層 1 4 の凹部 1 4 a の深さは図 1 (a) に示す工程よりもさらに大きくなる。このとき、凹部 1 4 a の深さが 1 5 0 n m よりも小さくなるように、即ち、下層配線 1 3 の上部が露出しないようにエッチング条件を設定する。

【 0 0 4 7 】

具体的に、配線溝 1 5 b を形成する工程のうち、反射防止膜 1 6 をエッチングする工程では、エッチングガスにフルオロカーボンガスと酸素ガスとの混合ガスを用い、エッチング装置の下部電極温度を 3 0 ℃ 以上とする。これにより、窒化シリコンに対する酸化窒化シリコン及び酸化シリコンのエッチング選択比の値が 1 よりも大きくなる。ここで、膜厚が約 8 0 n m の反射防止膜 1 6 を完全にエッチングされるように第 2 の層間絶縁膜 1 5 が約 2 0 n m の深さ分だけオーバーエッチングされるようにエッチング時間を設定する。従って、酸化窒化シリコンの酸化シリコンに対するエッチング選択比の値が 1 よりも大きいので、このときエッチング停止層 1 4 の凹部 1 4 a がエッチングされる深さは 1 0 0 n m よりも小さい。

【 0 0 4 8 】

さらに、配線溝 1 5 b を形成する工程のうち、第 2 の層間絶縁膜 1 5 をエッチングする工程では、エッチングガスにフルオロカーボンガスと酸素ガスとの混合ガスを用い、エッチング選択比の値が 1 5 よりも大きくなるように設定する。ここで、前述の反射防止膜 1 6 を形成する工程により、配線溝形成領域は反射防止膜 1 6 の上面から約 1 0 0 n m の深さにまでエッチングされているため、第 2 の層間絶縁膜 1 5 を約 3 0 0 n m の深さ分だけエッチングして深さが約 4 0 0 n m の配線溝 1 5 b を形成する。従って、エッチング停止層 1 4 の凹部 1 4 a がエッチングされる深さが 2 0 n m よりも小さくなる。

【 0 0 4 9 】

このように、配線溝 1 5 b を形成する工程では、エッチング停止層 1 4 の凹部

1 4 a がエッチングされる深さは 1 2 0 n m よりも小さくなり、前述の孔部 1 5 a 形成工程によりエッチングされた深さと合計すると、凹部 1 4 a の深さは 1 5 0 n m よりも小さい。つまり、孔部 1 5 a 及び配線溝 1 5 b を形成する工程において、孔部 1 5 a の下側に位置するエッチング停止層 1 4 の膜厚が順次小さくされ、下層配線 1 3 の上側はエッチング停止層 1 4 の凹部 1 4 a により覆われた状態となる。

【 0 0 5 0 】

次に、図 2 (b) に示すように、アッシングにより第 2 のレジストパターン 1 8 を除去し、続いて第 2 の層間絶縁膜 1 5 の表面を洗浄した後、フルオロカーボンガスと酸素ガスとの混合ガスをエッチングガスとして用い、第 2 の層間絶縁膜 1 5 をマスクとしたドライエッチング法により、孔部 1 5 a の下部に露出したエッチング停止層 1 4 を除去する。これにより、凹部 1 4 a を下層配線 1 3 まで貫通し、貫通した凹部 1 4 a と孔部 1 5 a とによりビアホール 1 9 が形成される。

【 0 0 5 1 】

ここで、孔部 1 5 a の下部に露出したエッチング停止層 1 4 を完全に除去する工程により、下層配線 1 3 がプラズマ化したエッチングガスに曝されるが、エッチング装置のバイアス電力値を 5 0 0 W 以下に設定することにより、下層配線 1 3 に生じるダメージを低減することができ、下層配線 1 3 の腐食を防止することができる。

【 0 0 5 2 】

次に、図 2 (c) に示すように、スパッタ法又は金属めっき法を用いて孔部 1 5 a 及び配線溝 1 5 b の内側を含む第 2 の層間絶縁膜 1 5 の上の全面にわたって C u からなる導電膜 2 0 を形成した後、CMP 法により第 2 の層間絶縁膜 1 5 が露出するまで導電膜 2 0 をエッチングする。これにより、ビアホール 1 9 に形成された導電膜 2 0 が配線同士を接続するピアコンタクト 2 0 a となり、配線溝 1 5 b に形成された導電膜 2 0 が上層配線 2 0 b となる。

【 0 0 5 3 】

その後、図示はしないが、必要に応じて図 1 (b) 、図 1 (c) 及び図 2 (a) ～図 2 (c) に示す工程を繰り返すことにより所望の多層配線を形成すること

ができる。また、続いて、ボンディングパッド等を形成すると多層配線の形成された半導体装置として用いることができる。

【 0 0 5 4 】

以下、前述の形成方法において、所定のエッチング選択比を実現するためのエッチングガスの組成について図面を参照しながら説明する。

【 0 0 5 5 】

図 3 は本発明の一実施形態に係る多層配線の形成工程に用いるエッチングガスの混合比とエッチング選択比との関係及びエッチングガスの成分として用いるフルオロカーボンガスの組成とエッチング選択比との関係を示すグラフである。図 3 において、横軸はフルオロカーボンガスにおけるフッ素原子に対する炭素原子の組成比（C/F 比）の値を表し、縦軸は、窒化シリコンに対する酸化シリコンのエッチング選択比の値を示している。また、エッチングガスにおける酸素ガスに対するフルオロカーボンガスの混合比（フルオロカーボン/酸素比）の値を変化した場合のエッチング選択比の値の変化を示している。

【 0 0 5 6 】

図 3 に示すように、窒化シリコンに対する酸化シリコンのエッチング選択比の値は、C/F 比の値が大きくなるほど上昇し、且つフルオロカーボン/酸素比の値が大きくなるほど上昇する。特に、フルオロカーボンの C/F 比の値が 0.6 以上で且つエッチングガスのフルオロカーボン/酸素比の値が 0.7 以上であるとエッチング選択比の値は 1.0 よりも大きく、フルオロカーボンの C/F 比の値が 0.6 以上で且つエッチングガスのフルオロカーボン/酸素比の値が 0.8 以上であるとエッチング選択比の値は 1.5 よりも大きい。

【 0 0 5 7 】

従って、図 1 (c) に示す孔部 15 a 形成工程におけるエッチングは、C/F 比の値が 0.6 以上のフルオロカーボンガスと酸素ガスとを、酸素ガスに対するフルオロカーボンガスの比の値が 0.7 以上となるようにエッチング選択比の値を 1.0 よりも大きくすることができる。

【 0 0 5 8 】

また、図 2 (a) に示す配線溝 15 b 形成工程のうちの第 2 の層間絶縁膜 15

に対するエッチングは、C/F比の値が0.6以上のフルオロカーボンガスと酸素ガスとを、酸素ガスに対するフルオロカーボンガスの比の値が0.8以上となるように混合したエッチングガスを用いて行うことにより、エッチング選択比の値を1.5よりも大きくすることができる。

【0059】

以上説明したように、本実施形態の多層配線の形成方法によると、エッチング停止層14の上に形成された第2の層間絶縁膜15にビアホール19となる孔部15aと配線溝15bとを形成する工程において、エッチング停止層14がエッチングされる深さを下層配線13が露出しないように小さくすることにより、有機材料を孔部15aに充填することなく下層配線13をダメージから保護することができるため、配線溝15bにクラウンフェンスが生じることがなく、信頼性の高い多層配線を形成することができる。

【0060】

また、エッチング停止層14を除去して孔部15aの下側に下層配線13を露出する工程において、エッチング装置のバイアス電圧を小さくすることにより、エッチング時のプラズマガスによる下層配線13に対するダメージを小さくすることができる。

【0061】

なお、本実施形態では、エッチング停止層14の膜厚を約150nm、第2の層間絶縁膜15の膜厚を約700nm、また反射防止膜16の膜厚を約80nmとして形成し、孔部15a及び配線溝15b形成工程においては、これらの膜厚に合わせて配線溝15bを形成した後に下層配線13が露出しないようにエッチング条件を設定してエッチング停止層14の凹部14aに対するエッチングの深さを調節したが、各層の膜厚及び配線溝15bの深さが異なる場合であっても、エッチング条件を適宜設定することにより、孔部及び配線溝を形成する工程で下層配線が露出しないように凹部14aがエッチングされる深さを調節することが可能である。

【0062】

また、本実施形態では、反射防止膜16を第2の層間絶縁膜15の上に設ける

ことにより、フォトリソグラフィ法によるパターンニングを精度良く行うように構成しているが、反射防止膜 1 6 を設けない場合であっても、エッチング停止層 1 4 及び層間絶縁膜 1 5 の膜厚と配線溝 1 5 b の深さに応じてエッチング条件を適宜設定することにより、孔部及び配線溝を形成する工程で下層配線が露出しないように凹部 1 4 a がエッチングされる深さを調節すればよい。

【 0 0 6 3 】

(多層配線の検査方法)

前述の一実施形態に係る多層配線の形成方法において、下層配線 1 3 の表面がダメージを受けて信頼性を低下することを防止するためには、図 2 (b) に示す工程でエッチング停止層 1 4 を完全に除去するよりも前の工程において、凹部 1 4 a の下部に下層配線 1 3 が露出していないことが重要である。

【 0 0 6 4 】

以下、前述の一実施形態に係る多層配線の形成方法により形成された多層配線の検査方法について図面を参照しながら説明する。

【 0 0 6 5 】

図 4 は本発明の一実施形態に係る多層配線の形成方法により形成された多層配線の検査方法に用いる検査用配線を示している。なお、図 4 において、図 1 (a) ~ 図 1 (c) 及び図 2 (a) ~ 図 2 (c) と同一の部材については同一の符号を付すことにより説明を省略する。

【 0 0 6 6 】

図 4 に示すように、本実施形態の検査方法に用いる検査用配線として、半導体基板 1 1 の上に検査用下層配線 2 1 が形成されており、第 2 の層間絶縁膜 1 5 の孔部 1 5 a 及びエッチング停止層 1 4 の凹部 1 4 a には検査用電極 2 2 a が、配線溝 1 5 b には検査用上層配線 2 2 b がそれぞれ形成されている。

【 0 0 6 7 】

ここで、検査用電極 2 2 a は、検査用下層配線 2 1 と検査用上層配線 2 2 b とが並列の配列を有するように配置されている。

【 0 0 6 8 】

図 4 に示す検査用配線の形成方法は、まず、図 1 (a) に示す工程と同様にし

て、下層配線 1 3 に換えて検査用下層配線 2 1 を形成し、続いて図 1 (b) 及び図 1 (c) に示す工程と同様にしてエッチング停止層 1 4、第 2 の層間絶縁膜 1 5 及び反射防止膜 1 6 を順次堆積し、第 2 の層間絶縁膜 1 5 に検査用電極 2 1 b を形成する領域として孔部 1 5 a を形成する。ここで、孔部 1 5 a は、図 1 (c) に示す工程と同じエッチング条件でエッチングすることにより検査用電極 2 2 a が形成される領域としてパターンニングする。

【 0 0 6 9 】

次に、図 2 (a) に示す工程と同様にして、同じエッチング条件で第 2 の層間絶縁膜の上部をエッチングすることにより、検査用上層配線 2 2 b を形成する領域として配線溝 1 5 b を形成した後、図 2 (c) に示す工程と同様にして孔部 1 5 a 及び配線溝 1 5 b の上に銅からなる導電膜 2 2 を形成して検査用電極 2 2 a 及び検査用上層配線 2 2 b を形成する。

【 0 0 7 0 】

本実施形態の多層配線の検査方法は、まず、前述のように検査用配線を形成し、次に、検査用下層配線 2 1 と検査用上層配線 2 2 b とに所定の電圧を印加して検査用下層配線 2 1 と検査用上層配線 2 2 b との間が導通するか否かを検査し、導通しない場合には、前述の多層配線の形成方法における配線溝 1 5 b を形成する工程のエッチング条件では下層配線 1 3 が露出しないと判定し、導通する場合には前述の多層配線の形成方法における配線溝 1 5 b を形成する工程のエッチング条件では下層配線 1 3 が露出すると判定する。

【 0 0 7 1 】

ここで、検査用電極 2 2 a は、検査用下層配線 2 1 と検査用上層配線 2 2 b との間に並列に配列されているため、検査用電極 2 2 a の下部のエッチング停止層 1 4 に少なくとも 1 箇所検査用下層配線 2 1 が露出している場合には、検査用下層配線 2 1 と検査用上層配線 2 2 b との間が導通する。

【 0 0 7 2 】

従って、多層配線形成工程において、エッチング条件の不適合や膜厚のばらつき等の影響により下層配線 1 3 が露出するという異常を高い感度で短時間に検出することが可能である。

【0073】

以上説明したように、本実施形態の多層配線の検査用配線によると、前述の多層配線の形成方法と同一の工程を用いて検査用配線を形成し、その導通を調べることにより、エッチング停止層14を段階的にエッチングして配線溝15b形成後に孔部15aの下部に下層配線13が露出しないように正常に行われたか否かを確認することができ、異常が検出された場合にはエッチング条件を再設定することにより、下層配線13の信頼性を確保することができる。

【0074】

なお、本実施形態において、下層配線13は、半導体基板11上に形成された集積回路素子の素子電極に接続されると説明したが、これに限られず、半導体基板11上に形成された他の配線と接続されていてもよい。

【0075】

また、下層配線13、ビアコンタクト20a及び上層配線20bを構成する材料は銅に限られず、例えばアルミニウムやタングステン等の導電性材料を用いてもよい。また、下層配線13とビアコンタクト20a及び上層配線20bとにそれぞれ異なる導電性材料を用いてもよい。

【0076】

【発明の効果】

本発明の多層配線の形成方法によると、ビアホールとなる孔部及び配線溝を形成した後にエッチング停止層により下層配線が確実に保護されるため、孔部に有機膜を形成することなく下層配線をエッチングによるダメージから保護することができ、配線溝にクラウンフェンスが生じることがない。また、孔部及び配線溝を形成する工程において、エッチング停止層における孔部の下側部分の膜厚が小さくされるため、孔部の下側の下層配線を露出する工程において、エッチング装置の電力を小さくしてエッチング停止層を除去することができるので、下層配線がエッチングによって受けるダメージが低減される。従って、製造コストを増大させることなく多層配線の信頼性と製造歩留まりとを向上することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の一実施形態に係る多層配線の形成工程を示す工程順の構成断面図である。

【図 2】

本発明の一実施形態に係る多層配線の形成工程を示す工程順の構成断面図である。

【図 3】

本発明の一実施形態に係る多層配線の形成工程に用いるエッチングガスの混合比とエッチング選択比との関係及びエッチングガスに用いるフルオロカーボンガスの組成とエッチング選択比との関係を示すグラフである。

【図 4】

本発明の一実施形態に係る多層配線の形成方法により形成された多層配線を検査するための検査用配線を示す構成断面図である。

【図 5】

第 1 の従来例に係る多層配線の形成工程を示す工程順の構成断面図である。

【図 6】

第 1 の従来例に係る多層配線の形成工程を示す工程順の構成断面図である。

【図 7】

第 1 の従来例に係る多層配線の形成工程を示す工程順の構成断面図である。

【図 8】

第 2 の従来例に係る多層配線の形成工程を示す工程順の構成断面図である。

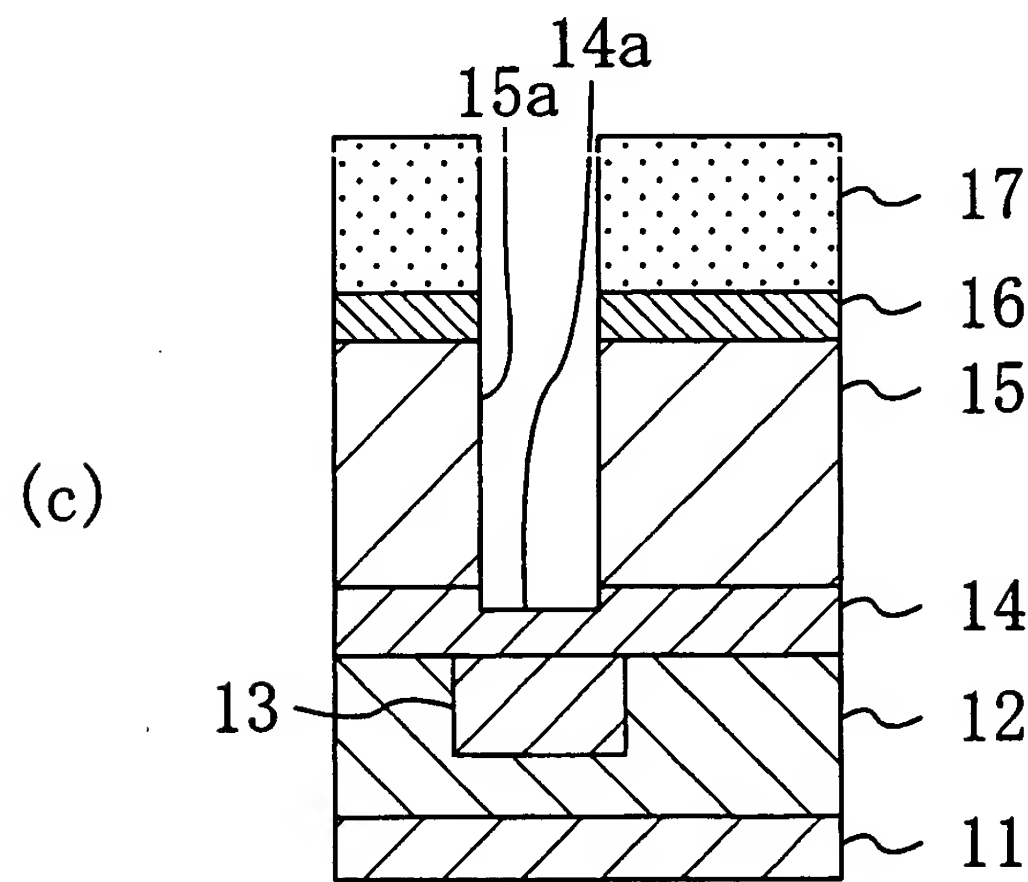
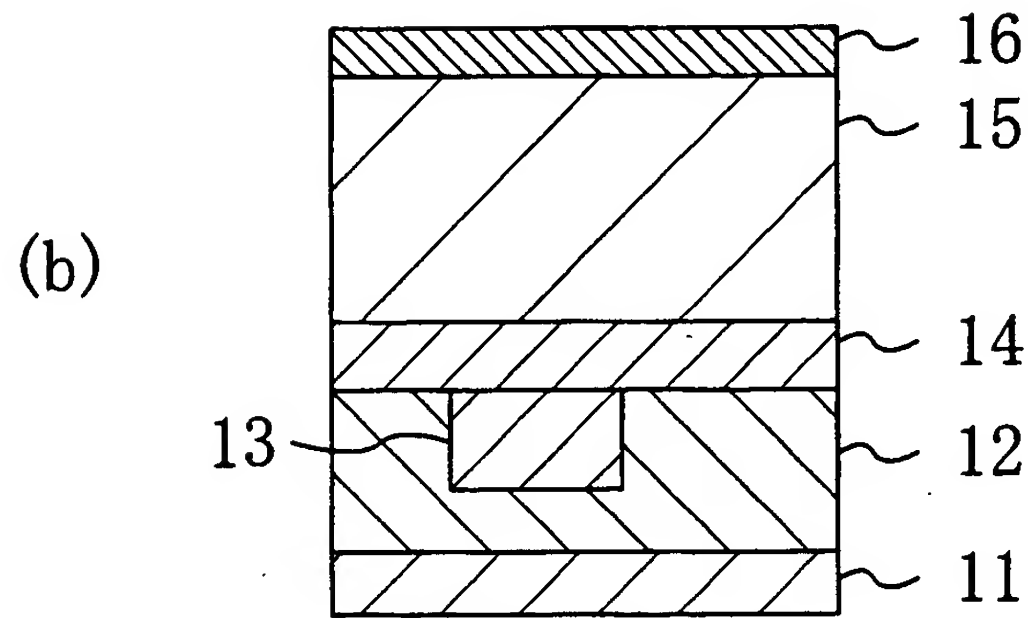
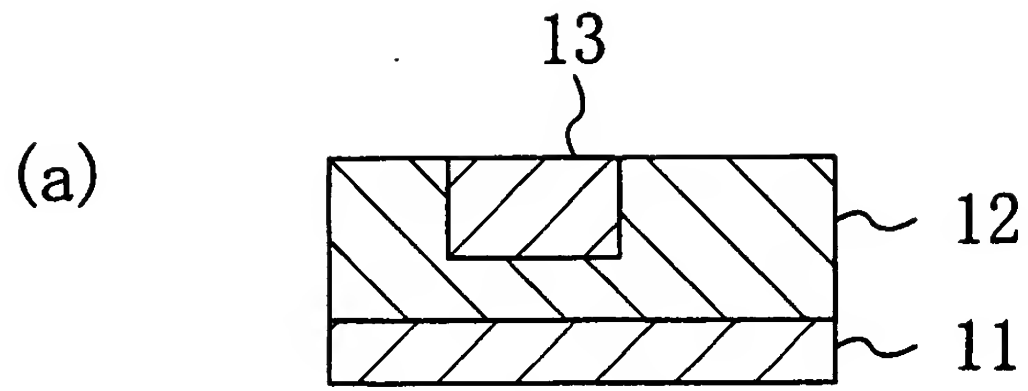
【符号の説明】

- 1 1 半導体基板
- 1 2 第 1 の層間絶縁膜（第 1 の絶縁膜）
- 1 3 下層配線
- 1 4 エッチング停止層（第 2 の絶縁膜）
- 1 4 a 凹部
- 1 5 第 2 の層間絶縁膜（第 3 の絶縁膜）
- 1 5 a 孔部

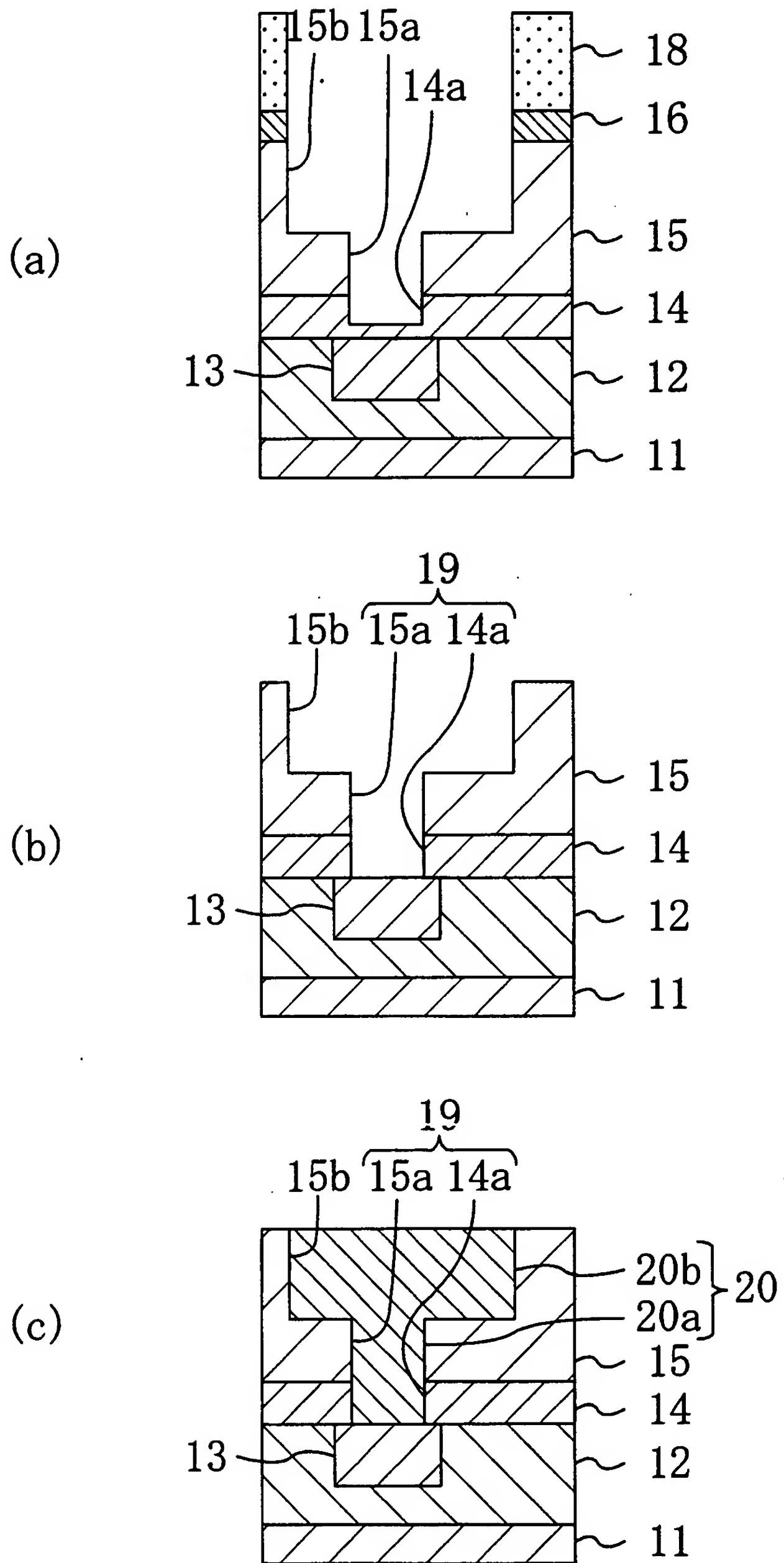
- 1 5 b 配線溝
- 1 6 反射防止膜
- 1 7 第 1 のレジストパターン
- 1 8 第 2 のレジストパターン
- 1 9 ビアホール
- 2 0 導電膜
- 2 0 a ビアコンタクト（接続部）
- 2 0 b 上層配線
- 2 1 検査用下層配線
- 2 2 導電膜
- 2 2 a 検査用上層配線
- 2 2 b 検査用電極

【書類名】 図面

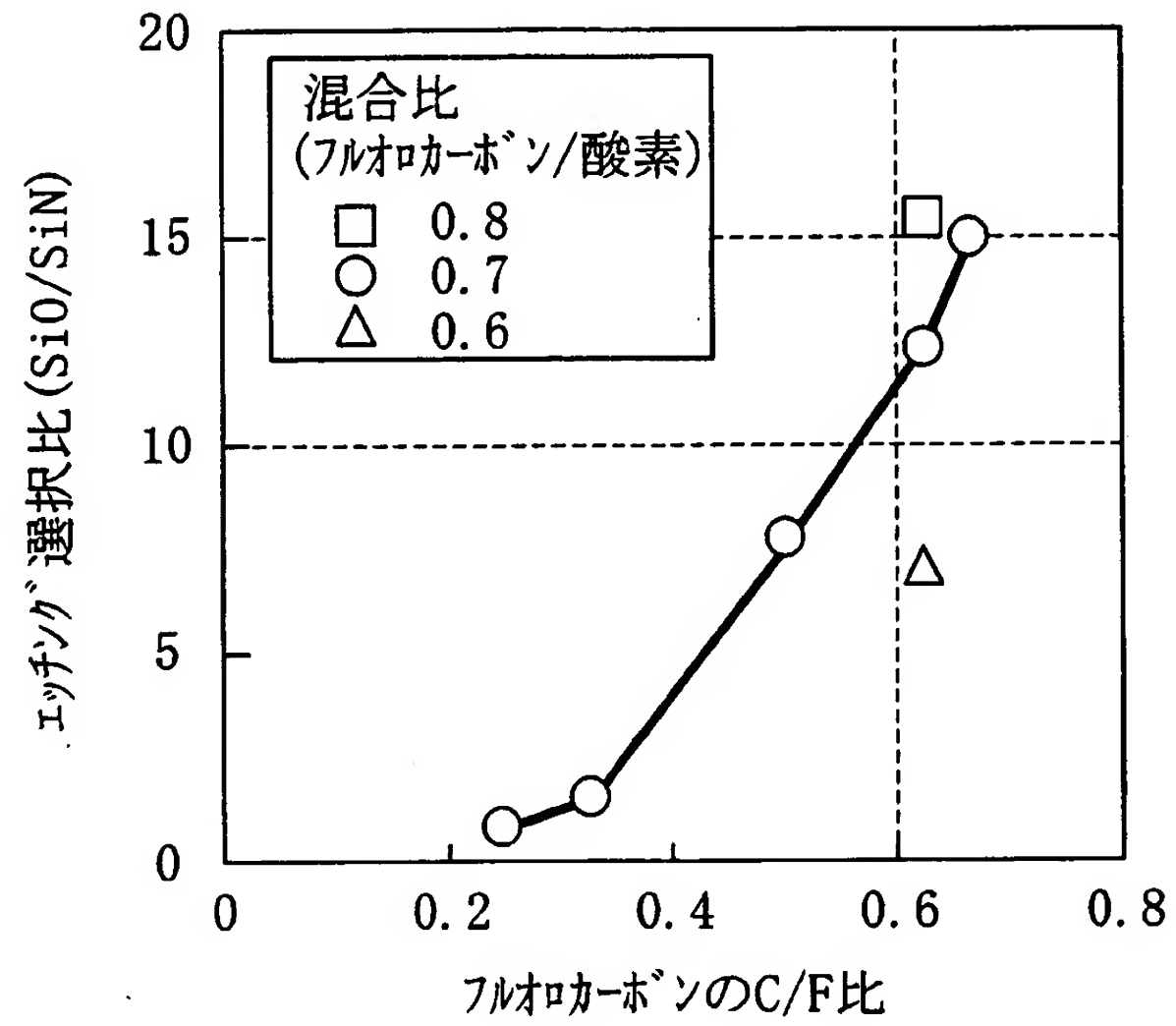
【図 1】



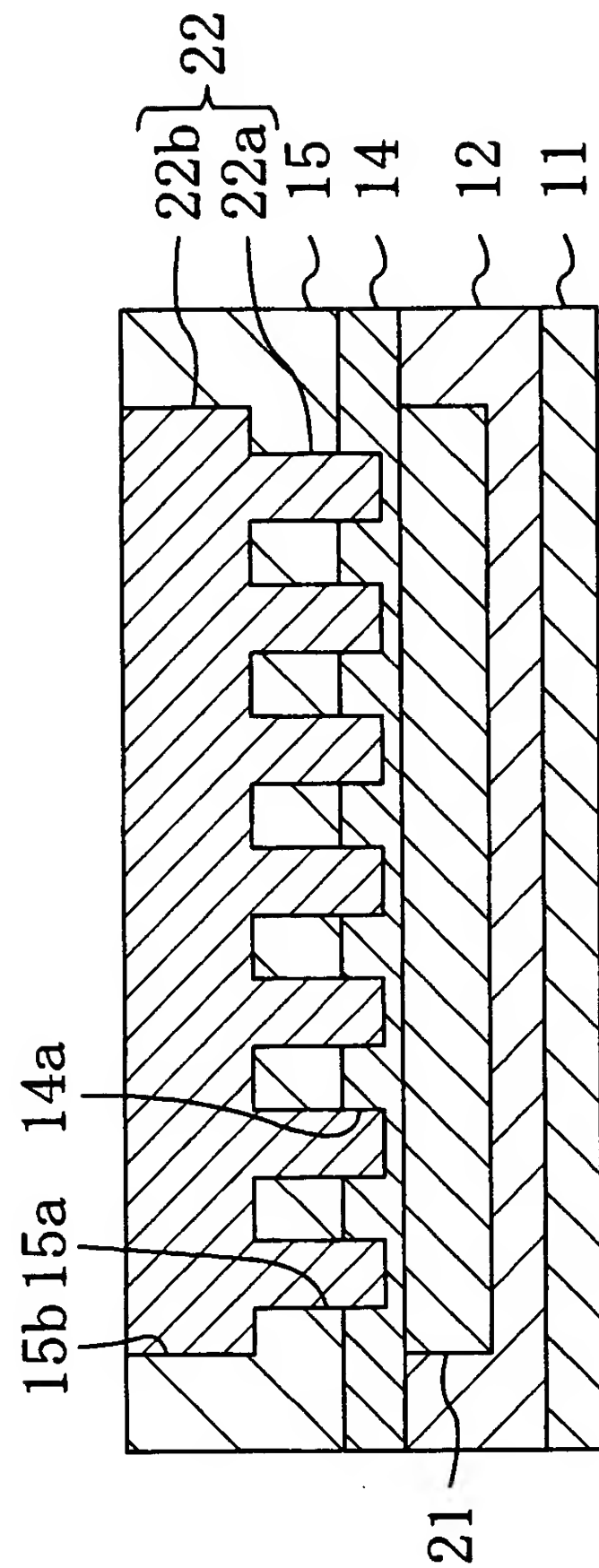
【図 2】



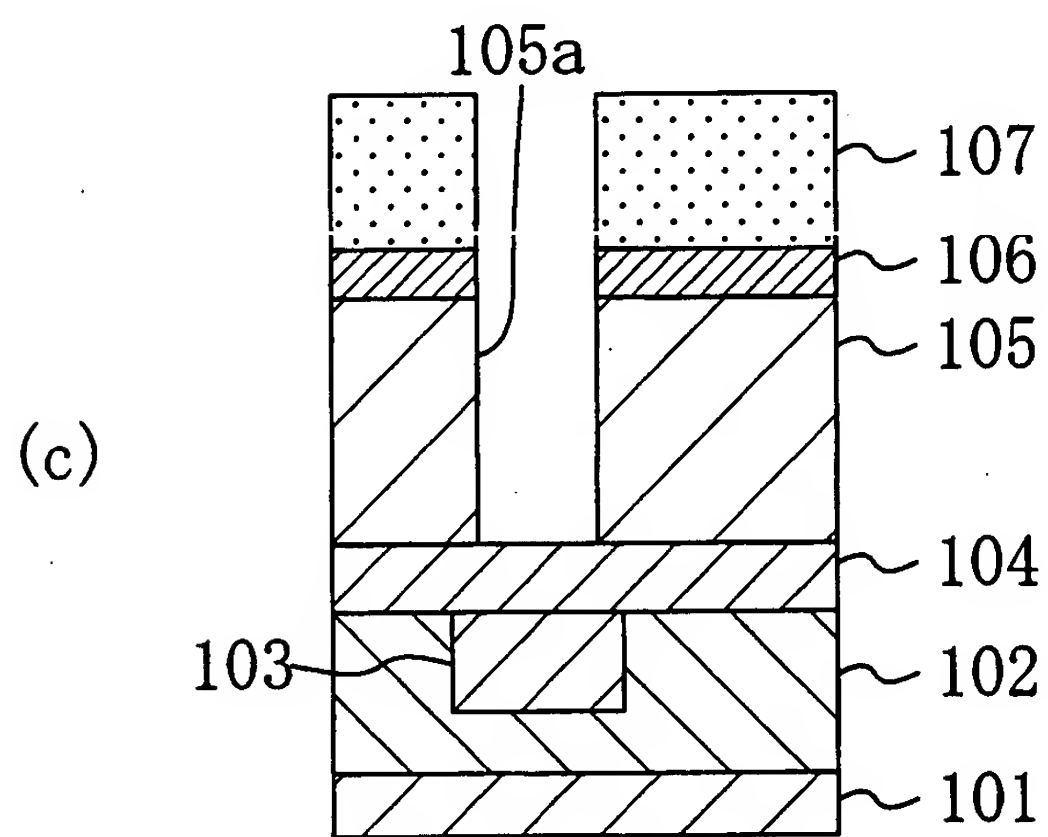
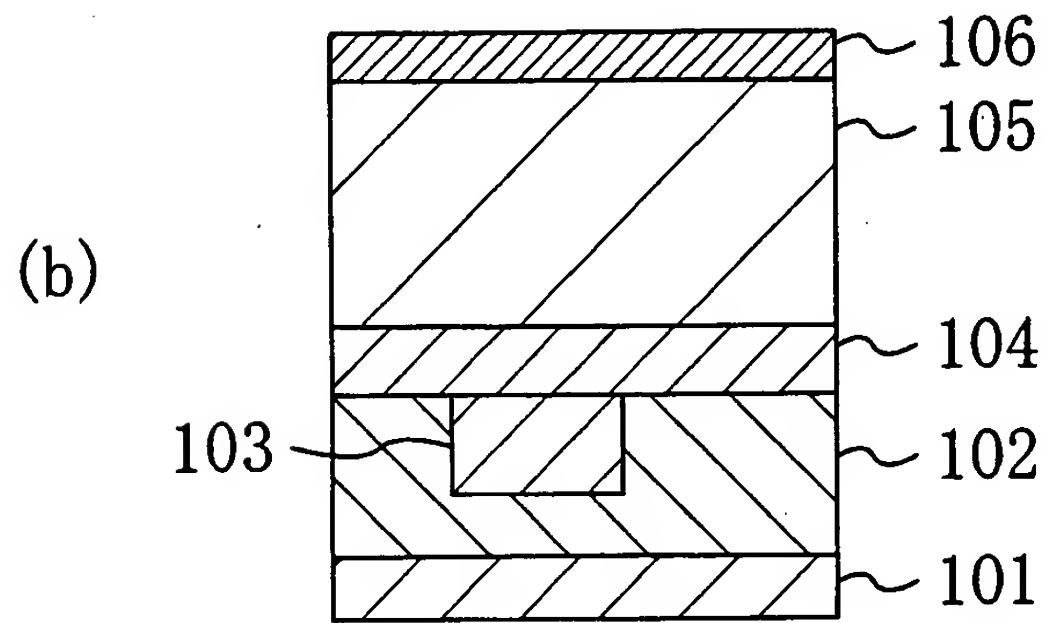
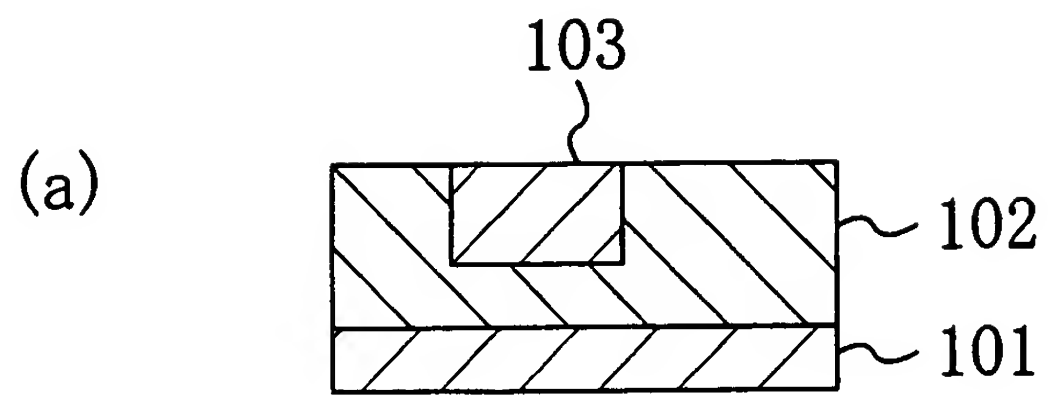
【図 3】



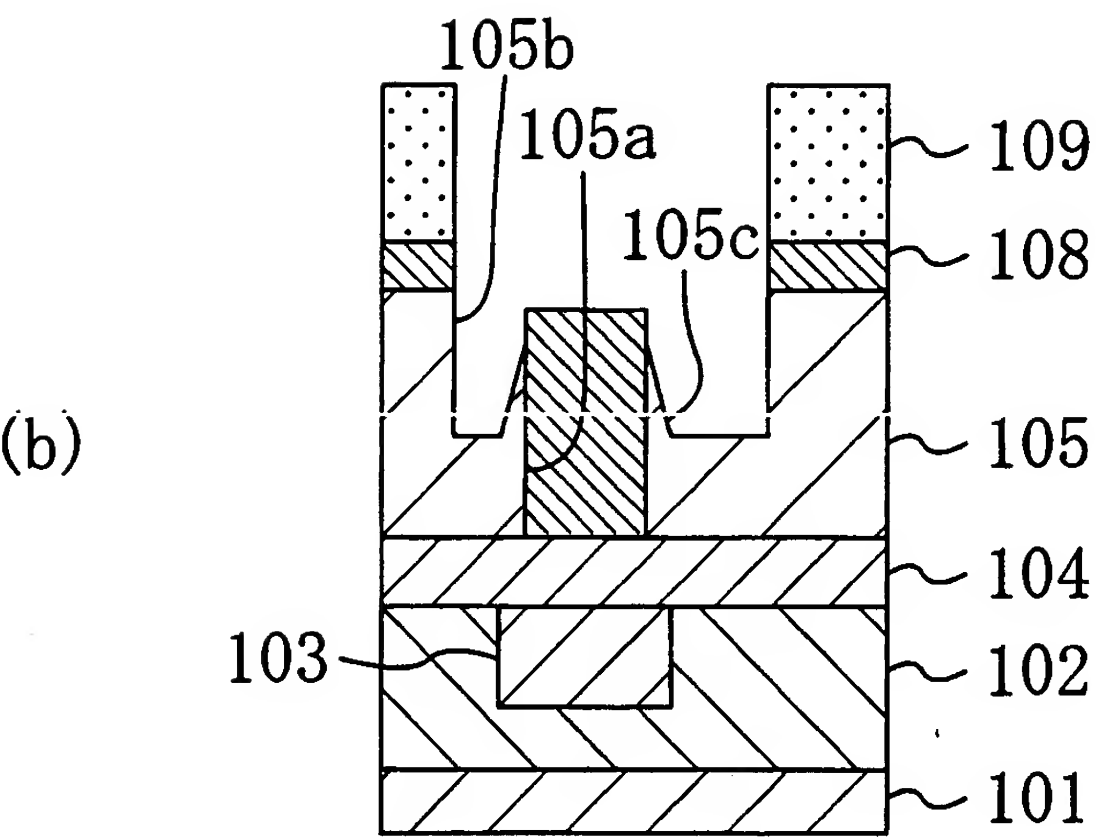
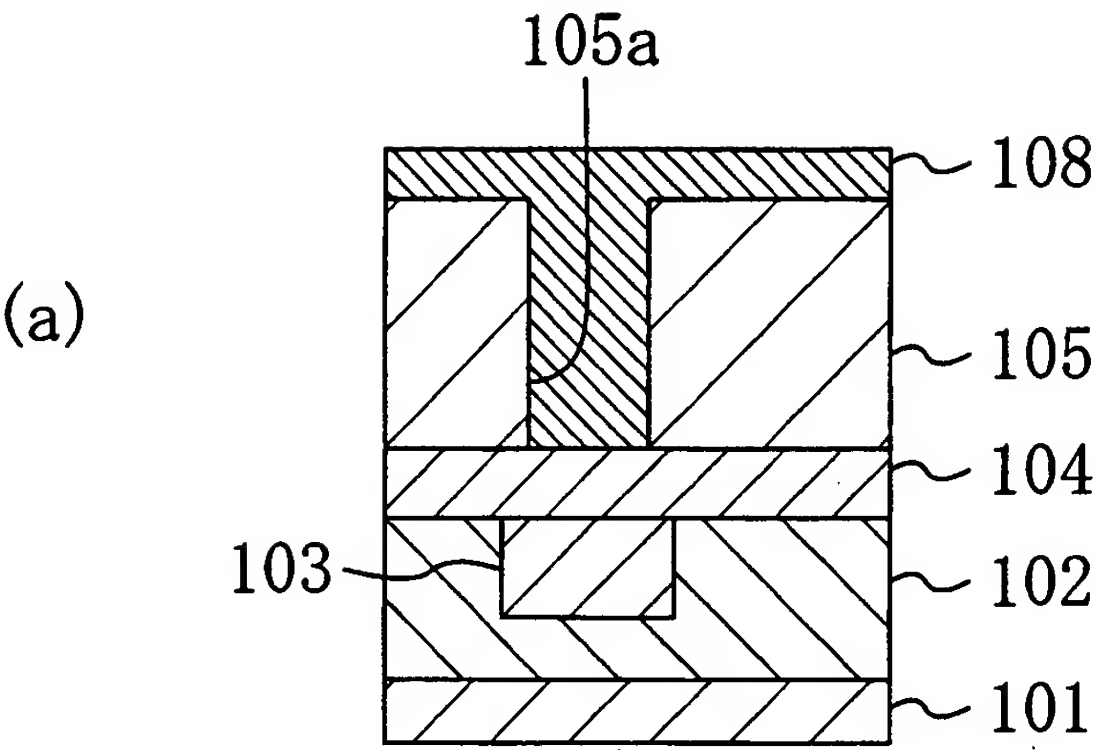
【図 4】



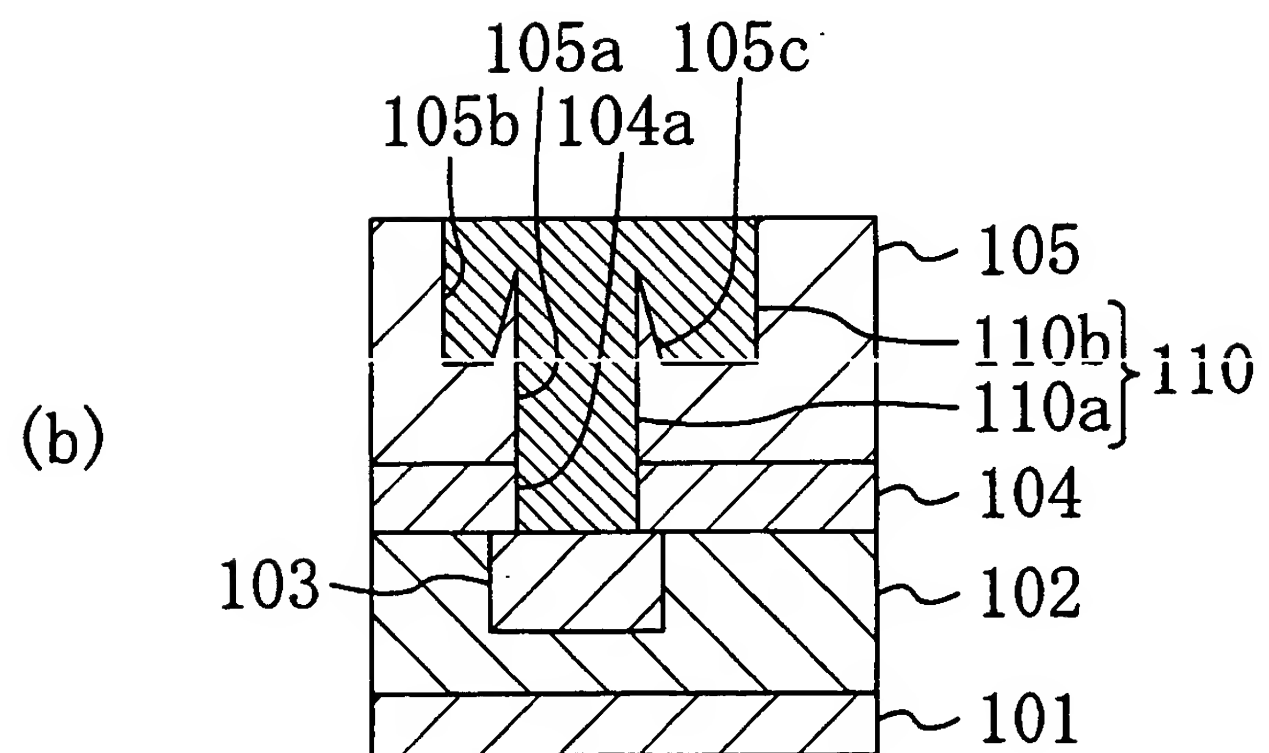
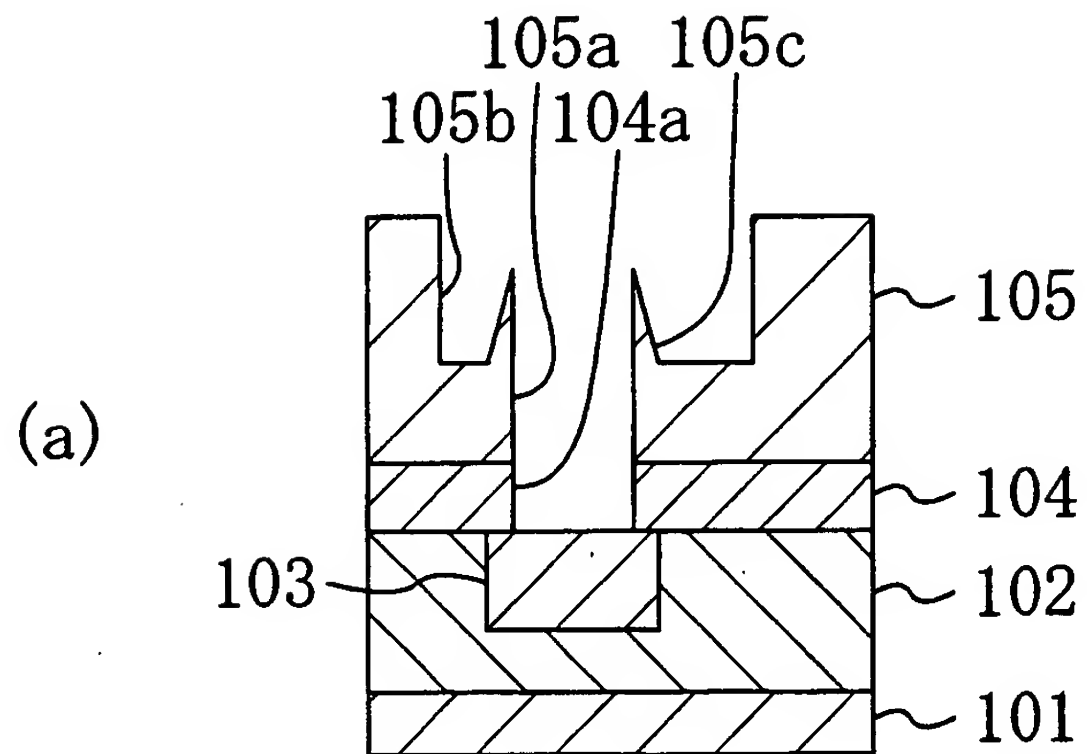
【図 5】



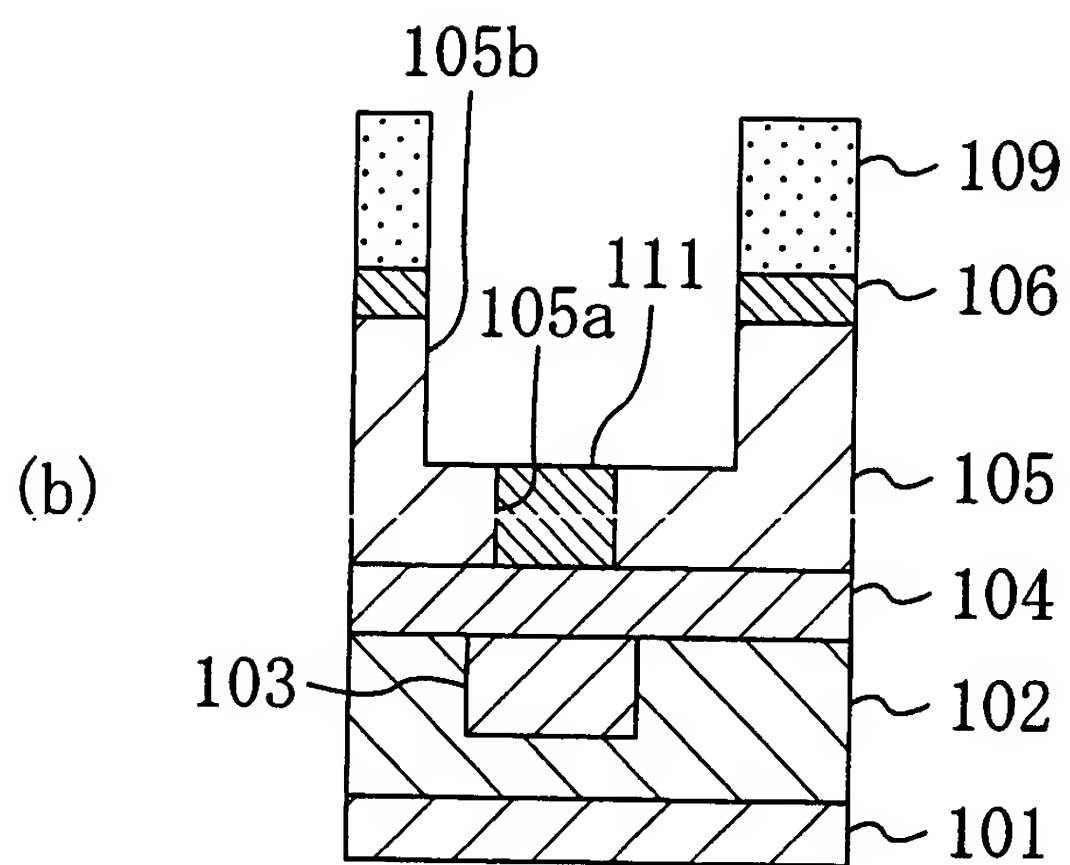
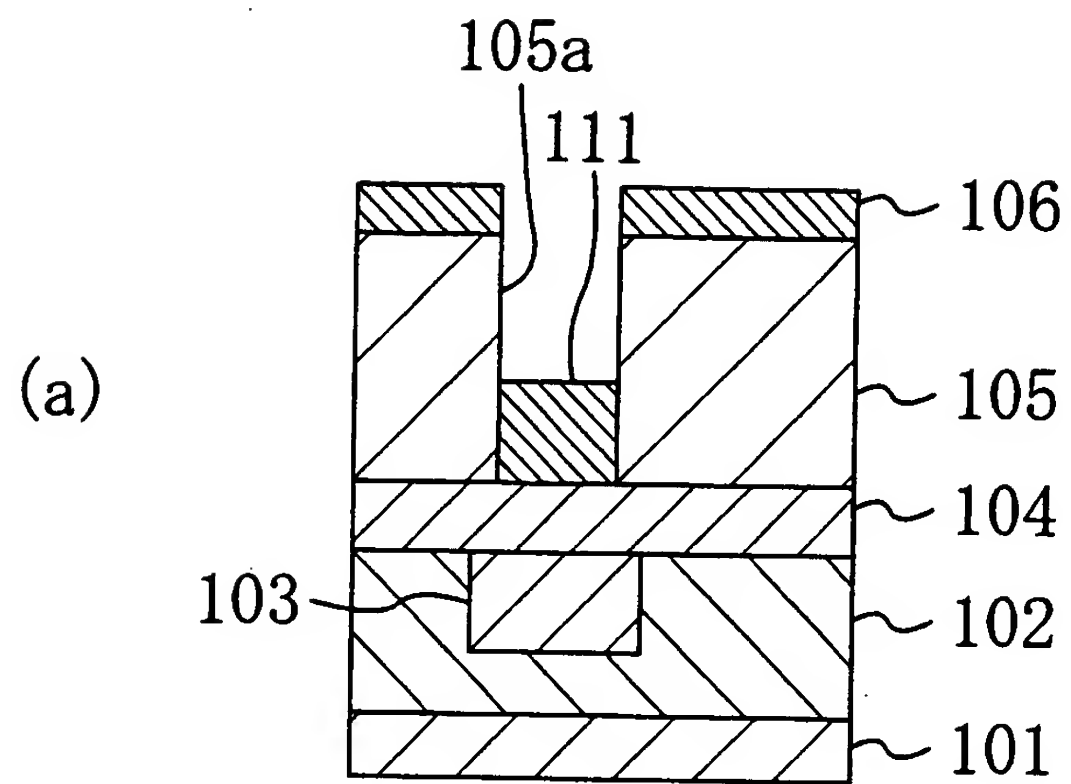
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ビアホール周囲にクラウンフェンスが生じないように配線溝を形成し、且つビアホール及び配線溝を形成する工程のエッチングによるダメージから下層配線を保護して多層配線の信頼性及び製造歩留まりを向上できるようにする。

【解決手段】 半導体基板 1 1 上の第 1 の層間絶縁膜 1 2 に下層配線 1 3 をパターニングした後、エッチング停止層 1 4 及び第 2 の層間絶縁膜 1 5 及び反射防止膜 1 6 を順次堆積する。次に、第 2 の層間絶縁膜 1 5 に孔部 1 5 a 及び配線溝 1 5 b を順次パターニングする。このとき、下層配線 1 3 が露出しないようにエッチング条件を設定してエッチング停止層 1 4 に凹部 1 4 a を形成する。次に、孔部 1 5 a の下側に位置するエッチング停止層 1 4 を除去し、続いて下層配線 1 3 を露出した後にビアコンタクト 2 0 a 及び上層配線 2 0 b を形成する。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地

氏 名 松下電器産業株式会社